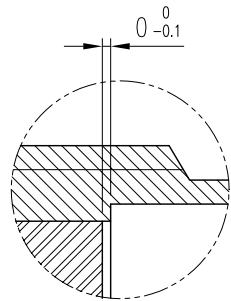
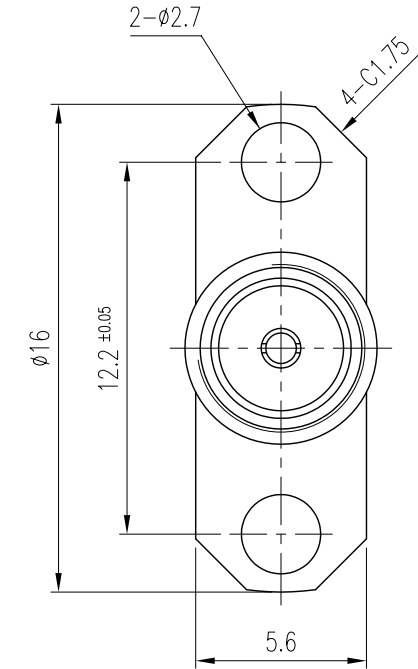
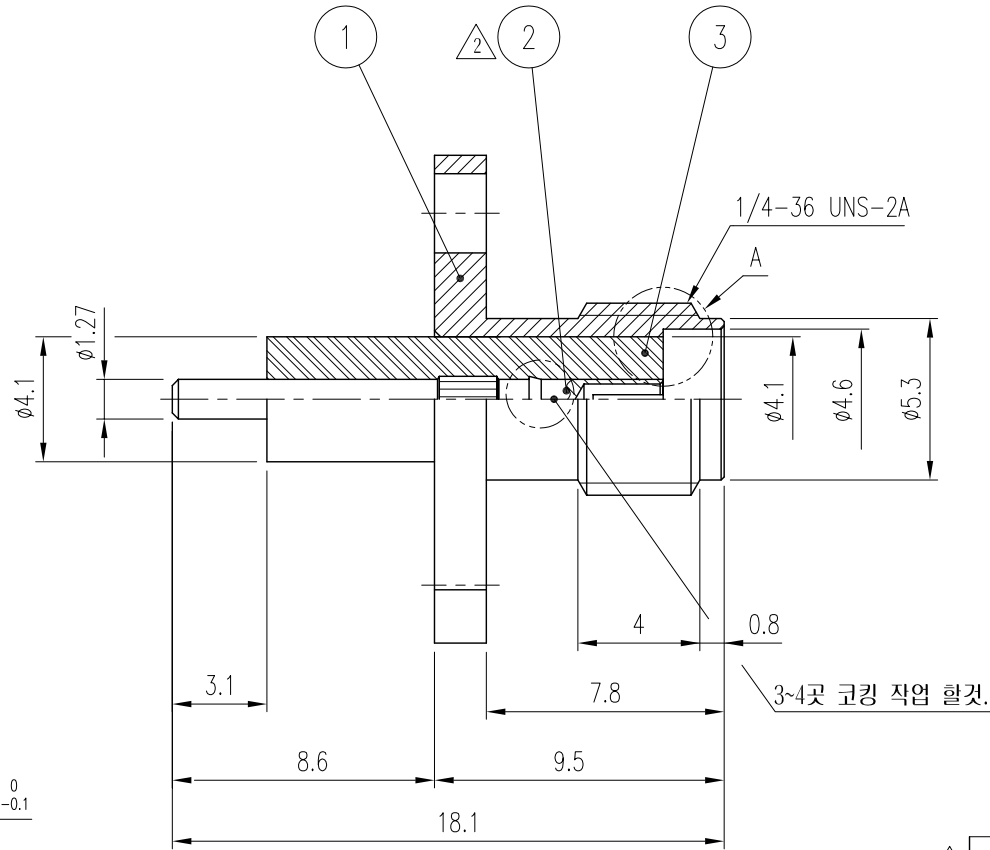


ST	가공	수 정 내 용									
		부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
ST(기초)		1	조립성 향상(절변No.연구2006-048) (TEFLON 삽입고관 굽도변경)	김은희	최종락	2006.	2.	25.			
ST(개선)		2	신뢰성 향상(절변No.연구2006-149) (PIN 밀랍 방지 뉘시마늘 삽입)	김인철	윤상진	2006.	7.	27.			



A부 확대도

1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00160-N/1 DIN00157-N/1
2	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00240-5/1
	1	BODY	1	MBSBD	Gold Plate	DBD00347-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일	2006. 02. 20.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
소수 각도 분수	승인					
재질	검도					
열처리	제도		도명			
보호파막처리	작성부서	연 구 소	SMAJ-H2-R VER.2			
	척도 4/1	단위 mm	중량	A4	도번	CN01332-7/1
						K314-480-035